

设备展6月起航,赶紧注册参观、SEMI-e2024第六届国际半导体技术暨应用展览会

产品名称	设备展6月起航,赶紧注册参观、SEMI-e2024第六届国际半导体技术暨应用展览会
公司名称	中国（耀瀚）展会信息
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	17810353883 17810353883

产品详情

SEMI-e2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会

展览时间：2024年06月26-28日展览地点：深圳市国际会展中心（宝安新馆）

SEMI-e2024第六届深圳国际半导体技术暨应用展览会于2024年6月26日至28日在深圳会展中心隆重举行。作为亚洲具影响力的半导体行业盛会，本次展览会吸引了来自全球各地的半导体企业、研究机构、专家学者和业界精英齐聚一堂，共同探讨半导体产业的发展趋势、技术创新和应用前景。

展览会上，众多参展商展示了他们在半导体领域的和产品，涵盖了半导体材料、设备、制造、封装测试等各个环节。其中，一些企业更是带来了他们的新研发成果，如先进的制程技术、高性能的芯片产品、创新的封装解决方案等，充分展示了半导体技术的新进展和趋势。

现场汇集了声光视讯显元宇宙六大产业链品牌，各dapinpai展品惊艳亮相，众多买家团悉数莅临现场共同展开跨领域技术交流与贸易合作，掀起采购热潮！精良国产化关键设备、先进芯片及器件、鲜艳细腻的LED显示表现、前沿VR/AR设备等令买家团眼前一亮。

展示范围1、设计、芯片、晶圆制造与封装：集成电路设计及芯片、晶圆制造、SiP先进封装、功率器件封测、MEMS封测、硅晶圆及IC封装载板、封装基板与应用制造与封测、EDA、MCU、封装基板半导体材料与设备及零部件等

2、先进材料：硅片及硅基材料、光掩模板、电子气体、光刻胶及其配套试剂、CMP抛光材料、靶材、封装基板、引线框架、键合丝、陶瓷基板、芯片粘合材料等

3、IC载板/陶瓷基板：IC载板及封装工艺(基板、铜等结构材料及干膜、金盐等化学品/耗材) Chiplet封装技术、存储、MEMS及芯片应用及材料、设备。陶瓷基板与封装材料及设备等

- 4、半导体显示/Mini/Micro-LED：OLED、AMOLED、Mini/Micro LED显示、柔性显示与材料及设备等
- 5、半导体专用设备&零部件：减薄机、单品炉、研磨机、热处理设备、光刻机、刻蚀机、离子注入设备、CVD/PVD设备、清洗设备切割机、装片机、键合机、测试机、分选机、探针台及零部件等
- 6、第三代半导体：氮化(GaN)和碳化硅(SiC)、氧化锌(ZnO)、金刚石、晶圆、衬底与外延、功率器件、IGBT封装材料、射频器件及加工设备等
- 7、元器件：无源器件、半导体分立器件/IGBT、5G核心元器件特种电子、元器件。电源管理、传感器、存储器、连接器继电器、线缆、接插器件、晶振、电阻、显示器件、二极管、三极管滤波元件、开关及元器件材料及设备等
- 8、机器视觉与传感器：各类感知元件、执行器、智能传感器、工业传感器、传感器芯片、传感器生产与制造设备、配件等
- 9、电源&储能技术：储能电源及传感器、电池管理芯片、功率半导体器件及材料和相关设备、仪器及零部件等
- 10、毫米波雷达/激光雷达/自动驾驶：毫米波雷达模组、射频芯片、天线及高频PCB、高频材料、生产组装设备等汽车雷达传感器上下游供应链各环节产品等
- 11、微电子综合智造区：电子自动化、机器自动化、视觉检测、环保、清洗设备、检测设备、测试仪器、配件等
- 12、AI与算力、算法、存储、CPO共封装：人工智能芯片、方案、算力芯片及方案、算法方案数据存储、光电共封装模块及技术和设备等
- 13、汽车半导体/车规级先进封装技术：车规级半导体主控/计算类芯片、功率半导体(IGBT和MOSFET)、车规级SiC模块、电源管理芯片、汽车电子微组装及功率器件、封装测试设备、自动化设备、国际半导体材料商、设备商、封测、制造、代工厂商等

在同期举办的论坛上，与会专家学者就半导体产业的未来发展进行了深入的探讨。他们普遍认为，随着人工智能、物联网、5G等新兴技术的快速发展，半导体产业正迎来前所未有的发展机遇。同时，他们也指出了半导体产业面临的挑战，如技术瓶颈、市场竞争、人才短缺等问题，并提出了相应的解决策略。